

H01G コンデンサ; 電解型のコンデンサ, 整流器, 検波器, 開閉装置, 感光装置 また感温装置 (誘電体としての特定の材料の選択 H01B3/00; 電位障壁または表面障壁を有するコンデンサ H01L29/00)

注

このサブクラスにおいては, グル - プ H01G11/00 はグル - プ H01G4/00 および H01G9/00 に優先する。[2013.01]

サブクラス内の索引

コンデンサ
 固定コンデンサ..... 4/00
 可変コンデンサ: 機械的手段によるもの; 非機械的手段によるもの..... 5/00
 ;7/00
 細部..... 2/00
 電解型装置..... 9/00
 構造的組み合わせ..... 15/00,17/00
 製造..... 4/00,5/00,7/00,9/00,13/00

2/00 グル - プ H01G4/00-H01G11/00 のうちの 1 つのグル - プにも包含されないコンデンサの細部 [6]
 2/00 101 ・コンデンサの電気的特性を修正または補償するための回路 (インピ - ダンス回路網 H03H)
 2/02 ・取り付け [6]
 2/02 101 ・・取付機構を有するもの
 A 取付けバンドを用いたもの
 B 取付け容器を用いたもの
 C 取付け具を用いたもの (H01G2/02 101A,B 優先)
 D コンデンサ素子収納ケ - ス自体に取付け部を形成したもの
 E 複数のコンデンサの取付け, 例 . アレイまたはモジュ - ル
 Z その他のもの
 2/04 ・・特にシャ - シ - への取り付けに適合するもの [6]
 2/06 ・・特に印刷回路基板への取り付けに適合するもの [6]
 A リ - ド型素子を取付けるもの
 B ・リ - ドに加工を施したもの
 C 印刷回路基板自体に特徴を有するもの
 Z その他のもの
 2/06 500 ・・表面実装, 例 . チップコンデンサ
 2/06 501 ・・・素子自体を印刷回路基板の孔に取付けるもの
 2/08 ・冷却装置; 加熱装置; 通気装置 [6]
 A 放熱または冷却に関するもの
 B 油量調整に関するもの
 Z その他のもの
 2/10 ・容器; 外装 [6]
 A 電力用コンデンサ
 B 締付
 C 容器
 D ・筒状容器
 E ・油入容器
 J 被覆
 K ・モ - ルド
 Q ・・浸漬によるもの, 例 . ディッピング
 R ・・型でモ - ルドするもの

L ・被覆筒体の封口
 M カバ - , 保護ケ - ス
 P 固体コンデンサ以外の形式のコンデンサにも適用されるもの
 Z その他のもの (チップ枠 H01G2/06)

2/10 300 ・・封止, 例 . リ - ド線; 蓋
 2/10 301 ・・・封口
 2/10 600 ・・容器内でのコンデンサの固着
 2/12 ・腐食に対する保護 (H01G2/10 が優先) [6]
 2/14 ・電氣的または熱的過負荷に対する保護 (冷却によるもの H01G2/08) [6]
 2/14 101 ・・電氣的過負荷に対する保護
 A 放圧を行うもの
 Z その他のもの
 2/14 103 ・・・コンデンサと並列に放電間隙が組み込まれたもの
 2/14 104 ・・・物理的または化学的に異常を検知する手段が取り込まれたもの
 2/14 105 ・・・・異常電流を検知する手段が組み込まれたもの
 D 伝達手段に特徴を有するもの
 Z その他のもの
 2/14 106 ・・・・異常温度を検知する手段が組み込まれたもの
 2/14 107 ・・・・発生するガスを検知する手段が組み込まれたもの
 2/14 108 ・・・コンデンサが容器内で直接樹脂充填されたもの
 B 異常電流を検知するもの
 C 異常温度を検知するもの
 D 放圧構造を有するもの
 Z その他のもの
 2/16 ・・ヒュ - ズ素子を有するもの [6]
 2/16 101 ・・・強制短絡を行うもの
 2/16 201 ・・・遮断警報を有するもの
 2/16 301 ・・・温度ヒュ - ズを有するもの
 2/18 ・・遮断可能な接点を有するもの [6]
 2/18 101 ・・・スイッチを用いるもの
 2/20 ・電極の端部から放電を防ぐための装置 [6]
 2/22 ・静電遮蔽または磁気遮蔽 [6]
 2/24 ・表示マ - ク, 例 . カラ - コ - ド [6]
 4/00 固定コンデンサ; その製造方法 (電解コンデンサ H01G9/00) [2]
 A 製造方法
 B 構造
 Z その他のもの
 4/002 ・細部 [6]
 4/005 ・・電極 [6]
 4/008 ・・・材料の選択 [6]
 4/008 500 ・・・・焼成電極
 4/01 ・・・自己支持電極型 [6]
 4/012 ・・・非自己支持電極型 [6]
 4/015 ・・・自己回復型 [6]
 4/018 ・・誘電体 [6]
 4/02 ・・・気体または蒸気誘電体 [2,6]
 4/04 ・・・液体誘電体 [2,6]
 4/06 ・・・固体誘電体 [2,6]
 4/08 ・・・・無機誘電体 [2,6]
 A マイカを用いるもの
 C 蒸着によるもの

	Z	その他のもの
4/10	 金属酸化物誘電体 [2,6]
4/10 500	 ガラスを用いるもの
4/12	 セラミック誘電体 [2,6]
4/12 090	 セラミック誘電体材料で特徴付けられるもの (H01G4/12 720, H01G4/12 810 が優先)
4/12 180	 酸化チタンまたはチタン酸塩を基とするもの (H01G4/12 450 が優先)
4/12 270	 アルカリ土類のチタン酸塩を基とするもの
4/12 360	 酸化ジルコニウムまたはジルコニウム酸塩を基とするもの (H01G4/12 630 が優先)
4/12 450	 チタン酸塩も含むもの
4/12 540	 ニオブまたはタングステン, 酸化タンタルまたはニオブ酸塩, タンタル酸塩を基とするもの
4/12 630	 酸化ジルコニウムまたはジルコニウム酸塩も含むもの
4/12 720	 半導体性セラミックコンデンサ
4/12 810	 粒界層を有するもの
4/12 900	 ガラス相を含むもの, 例. ガラスセラミック
4/14	 有機誘電体 [2,6]
4/14 500	 蒸着によるもの
4/16	 繊維性材料によるもの, 例. 紙 [2,6]
4/18	 合成物質によるもの, 例. 繊維素の派生物 (H01G4/16 が優先) [2,6]
4/18 300	 繊維素の派生物 (H01G4/14 500 が優先)
4/18 600	 ハロゲン化物 (H01G4/14 500 が優先)
4/20		... グル - プ H01G4/02-H01G4/06 までの二つ以上からの誘電体の組み合わせを用いるもの (H01G4/12 が優先) [2,6]
4/20 300		... 繊維性材料または合成物質
4/20 600		... 無機および合成材料
4/22		... 含浸したもの [2,6]
4/22 100		... 含浸物の組成に特徴を有するもの
4/22 200	 ハロゲン化物
4/224		.. 容器; 外装 [6]
4/224 100		... セラミックコンデンサの外装
4/224 200		... フィルムコンデンサの容器
4/228		.. 端子部 [6]
	A	基板への取付部の構造に特徴を有するもの
	B	電極への接続部の構造に特徴を有するもの
	E	リ - ドフレ - ムまたはチェ - ンリ - ド構体
	F	リ - ドの材料または断面構造に特徴を有するもの
	G	シャ - シ, その他の装置への取付に特徴を有するもの
	H	モ - ルド, その他の装置への取付に特徴を有するもの
	J	複数の部品の接続に関するもの
	K	特殊なコンデンサの端子, 例. 貫通型, 厚膜, 薄膜コンデンサ等の端子
	L	有機誘電体を用いるコンデンサの端子

	M	・巻芯または巻芯の閉塞
	Q	・樹脂注入封止型またはモ - ルド型のコンデンサの端子
	R	・保護装置に関連するもの
	S	・複数の素子の接続に関するもの
	T	・チップ化
	W	リ - ドを有するチップ型
	Z	その他のもの
4/232		... 積層型または巻回型コンデンサ - の二つ以上の層を電氣的に接続するもの [6]
	A	無機誘電体を有するもの
	B	端子の材料に特徴を有するもの
	E	電極と端子を機械的に接続または溶接, 半田により接続するもの
	Z	その他のもの
4/236		... 容器を通しリ - ドを引出すもの, すなわち, リ - ドスル - [6]
4/242		... 端子部を取り囲むコンデンサ素子 [6]
4/245		... 巻回型電極の層間のタブ [6]
4/248		... コンデンサ素子を包含または取り囲む端子部, 例. キャップ (H01G4/252 が優先) [6]
4/252		... コンデンサ素子に被覆される端子部 (H01G4/232 が優先) [6]
	B	メタリコン, 導電性塗料, 半田または蒸着に関するもの
	C	・メタリコン, 導電性塗料, 半田または蒸着の構造または材料に特徴を有するもの
	D	・メタリコン, 導電性塗料, 半田または蒸着による端子の接続に特徴を有するもの
	V	リ - ドレスチップ型
	Z	その他のもの
4/255		.. 容量値補正手段 [6]
4/258		.. 温度補償手段 [6]
4/26		・折り重ね型コンデンサ [2]
4/28		・チュ - ブラコンデンサ [2]
4/30		・積層型コンデンサ (H01G4/33 が優先) [2,6]
4/30 120		.. セラミック体中に形成した空洞に金属を注入して得られたもの
4/30 140		.. 他のコンデンサから得られたもの
4/30 160		.. 薄膜技術により作られたもの
4/30 180		.. 転写技術により作られたもの
4/30 201		.. 構造または材料
	A	積層構造
	B	内部電極
	C	・内部電極の構造
	D	・内部電極の材料
	E	外部電極
	F	・外部電極の構造
	G	・外部電極の材料
	H	・外部電極に接続するリ - ド
	J	誘電体
	K	・誘電体の構造
	L	・誘電体の材料
	M	・素子主面の誘電体に特徴を有するもの
	N	・素子側面の誘電体に特徴を有するもの
	P	チップ型
	Q	同軸型

	R	直列接続型		K	・粗面化したもの
	S	安全装置付のもの		L	誘電体フィルムの材料
	Z	その他のもの		P	金属化フィルム間に絶縁材を有するもの
4/30 311	..	製造方法		Z	その他のもの
	A	切断の仕方	4/32 521	非金属化フィルムの構造または材料
	B	・ドラムに巻いて切断する方法		A	電極箔
	C	・巻回後, 押しつぶして切断する方法		G	誘電体フィルム
	D	内部電極の製造方法		H	・電荷移動型錯体を有するもの
	E	外部電極の製造方法		J	・複雑塩
	F	積層の仕方		K	・単純塩
	Z	その他のもの		L	・不織布のもの
4/30 500	..	セラミックコンデンサ		P	電極箔と誘電体フィルムの組合せまたは配設
4/30 501	...	半導体磁器コンデンサ		Q	電極箔と誘電体フィルムの接着
4/30 504	粒界絶縁型かつ還元再酸化型		Z	その他のもの
4/30 506	粒界絶縁型	4/32 530	端面電極の構造, 例. メタリコン電極の構造
4/30 508	還元再酸化型	4/32 531	端面電極に接続されるリ - ド
4/30 510	...	積層セラミックコンデンサ (H01G4/30 501 が優先)	4/32 540	外装, モ - ルド, 容器またはガス封入
4/30 511	構造	4/32 541	含浸したもの
4/30 512	誘電体	4/32 542	チップ型
4/30 513	内部電極または外部電極	4/32 543	直列接続型
4/30 514	材料	4/32 544	安全装置付のもの, 例. ヒュ - ズ電極
4/30 515	誘電体	4/32 550	...	フィルムコンデンサの製造方法
4/30 516	内部電極または外部電極	4/32 551	金属化フィルムの製造方法
4/30 517	製法	A		容量形成電極の製造方法, 例. 蒸着方法
4/30 520	...	筒状型, 壺型または柱状回	B		誘電体フィルムの製造方法
4/30 530	...	巻回型	Z		その他のもの
4/30 540	...	基板印刷型, 例. 厚膜または薄膜コンデンサ	4/32 561	非金属化フィルムの製造方法
4/30 541	構造	A		電極箔の製造方法
4/30 544	材料	B		誘電体フィルムの製造方法
4/30 547	製法	C		・照射処理によるもの, 例. 光照射, 電子線照射等
4/30 550	...	貫通型	D		・放電処理によるもの
4/30 560	...	一般磁器コンデンサ, 例. 板状または U 字型コンデンサ	Z		その他のもの
4/32	・	巻回したコンデンサ [2]	4/32 571	熱処理
4/32 301	..	構造	4/32 572	圧縮または加工
	A	フィルムの組合せまたは配置	4/32 573	切断
	B	フィルム自体の構造	4/32 574	複数工程の処理
	C	安全装置付のもの	4/33	・	薄膜または厚膜コンデンサ [6]
	D	冷却パイプ付のもの	4/33 101	..	厚膜コンデンサ, 例. 誘電体が塗布または印刷等により形成されたコンデンサ
	E	チップ型	4/33 102	..	薄膜コンデンサ, 例. 誘電体が蒸着または陽極酸化等により形成されたコンデンサ
	F	外装または容器	4/35	・	貫通型コンデンサまたは雑音防止コンデンサ [6]
	Z	その他のもの	4/35 301	..	円筒型
4/32 305	リ - ドおよびリ - ド引出し部	4/35 311	..	巻回型
	A	リ - ド	4/35 321	..	同軸型
	B	端面電極, 例. メタリコン電極等	4/35 331	..	多層型
	Z	その他のもの	4/35 341	..	複合型
4/32 311	..	製造方法	4/38	・	複合コンデンサ, すなわち複数個の固定コンデンサの構造的組合せ [2]
	A	巻き方	A		固定コンデンサ同士のみで構成されるもの
	Z	その他のもの	B		単一構造体の複合コンデンサ
4/32 500	..	フィルムコンデンサ	Z		その他のもの
4/32 510	...	フィルムコンデンサの構造または材料			
4/32 511	金属化フィルムの構造または材料			
	A	容量形成電極の構造			
	D	容量形成電極の材料			
	G	誘電体フィルムの構造			
	H	・粉末または粒子を混入したもの			
	J	・網目要素をもつもの			

4/40	・このサブクラスに包含されない他の電気素子を有する固定コンデンサの構造的組合せであって、その構造が、主としてコンデンサからなるもの、例、コンデンサおよび抵抗複合部品 [2]	5/013 325 回転無軸型
A	固定コンデンサ以外の形式のコンデンサを含まないもの	5/013 330 筒型
Z	その他のもの	5/013 335 スライド型
4/40 301	・・抵抗素子と結合したもの	5/013 340 多連のもの
A	固定コンデンサ以外の形式のコンデンサを含まないもの	5/013 345 製造方法に特徴を有するもの
Z	その他のもの	5/013 350 極板に特徴を有するもの
4/40 304	・・・電圧非直線抵抗素子と結合したもの	5/013 351 固定電極に特徴を有するもの
A	固定コンデンサ以外の形式のコンデンサを含まないもの	5/013 352 移動電極に特徴を有するもの
Z	その他のもの	5/013 355 押圧部材に特徴を有するもの
4/40 310	・・・過電圧保護をなすもの	5/013 360 取付けに特徴を有するもの
A	固定コンデンサ以外の形式のコンデンサを含まないもの	5/013 365 端子に特徴を有するもの
Z	その他のもの	5/013 370 回転軸に特徴を有するもの
4/40 313	・・・放電ギャップまたは放電抵抗を有するもの	5/013 375 基板に特徴を有するもの
A	固定コンデンサ以外の形式のコンデンサを含まないもの	5/013 380 電極の有効面積の変化によるもの
Z	その他のもの	5/013 381 平らなまたは実質的に平らな電極を回転するもの
4/40 321	・・インダクタンス素子と結合したもの	5/013 385 電極の間隙変化によるもの
A	固定コンデンサ以外の形式のコンデンサを含まないもの	5/013 390 可動誘電体型
Z	その他のもの	5/014	・・容器; 外装 [6]
5/00	機械的手段によって容量を変えるコンデンサ、例、軸の回転によるもの; その製造方法 [2]	5/015	・・集電子
5/01	・細部	5/017	・・温度補償 [6]
B	伝導機構に特徴を有するもの	5/019	・・容量特性補正手段 [6]
C	回転軸に特徴を有するもの	5/04	・電極の有効面積の変化を利用するもの [6]
D	取付けに特徴を有するもの	5/06	・・平らなまたは実質的に平らな電極の回転によるもの [6]
E	A - スに特徴を有するもの	B	伝導機構に特徴を有するもの
F	シ - ルドに特徴を有するもの	C	回転軸に特徴を有するもの
G	端子に特徴を有するもの	K	容器に特徴を有するもの
H	振動防止に特徴を有するもの	L	極板に特徴を有するもの
J	基板に特徴を有するもの	M	・固定電極に特徴を有するもの
Z	その他	N	・移動電極に特徴を有するもの
5/011	・・電極 [6]	P	押圧部材に特徴を有するもの
5/012	・・・電極の少なくとも一つが、置換しうる液体または粉体であるもの [6]	Q	補助コンデンサに特徴を有するもの
5/013	・・誘電体 [6]	Z	その他
5/013 100	・・・誘電体として空気、ガスまたは真空を用いるもの（液体または固体誘電体の置換を用いるもの H01G5/013,200-H01G5/013,390）	5/08	・・・連続して可変とするもの [6]
5/013 200	・・・液体誘電体を用いるもの	5/10	・・螺旋電極の回転によるもの [6]
5/013 300	・・・固体誘電体を用いるもの	5/12	・・円筒状、円すい状または球状電極の回転によるもの [6]
5/013 310 可動電極型	5/14	・・電極の長手方向への移動によるもの [6]
5/013 315 誘電体の材料がプラスチックであるもの	5/16	・電極の間隙変化を利用するもの [6]
5/013 316 プラスチック材料に特徴を有するもの	5/18	・・傾きの変化によるもの、例、可撓性または螺旋重ねによるもの [6]
5/013 320 誘電体の材料が酸化物であるもの	5/38	・複合コンデンサ、例、ガング
5/013 321 誘電体の材料がガラスであるもの	5/40	・このサブクラスに包含されない他の電気素子を有する可変コンデンサの構造的組合せであって、その構造が主としてコンデンサからなるもの、例、RC 組合せ [6]
		7/00	機械的でない手段によって容量を変えるコンデンサ; その製造方法 [2]
		A	湿度センサ -
		Z	その他のもの
		7/02	・エレクトレット、すなわち永久双極子を有するもの
		A	組成に特徴を有するもの
		B	複層のもの
		C	・金属層を有するもの
		D	形に特徴を有するもの
		E	製造方法に特徴を有するもの
		F	・フツ素を含むもの

	G	・・フツ化ピニリデン	9/032	・・・無機半導体電解質，例．二酸化マンガ ン [6]
	H	・繊維状のもの	9/035	・・・液体電解質，例．含浸物質（H01G11 /54 が優先）[6]
7/04	Z	その他のもの	9/04	・・電極 [6]
		・与えられる温度によって誘電率が変化 するように選択された誘電体をもつもの	9/042	・・・材料に特徴を有するもの（H01G11 /22 が優先）[6]
7/06		・与えられる電圧によって誘電率が変化 するように選択された誘電体をもつもの，すなわち強誘電性コンデンサ（エ レクトレット H01G7/02）	9/042 500	・・・陰極に用いられるもの
9/00		電解型コンデンサ，整流器，検波器，開 閉装置，感光装置または感温装置；その 製造方法 [2]	9/045	・・・アルミニウムを基礎とするもの [6]
9/00 030		・電気的または熱的過負荷に対する保護； 冷却によるもの；陰極膜の形成を避ける 手段	9/048	・・・構造に特徴を有するもの（H01G11 /22 が優先）[6]
9/00 290		・製造方法に特徴を有するもの	A	素子の全体構造に特徴を有するもの
	A	誘電体層の形成	B	・巻回型
	B	・再化成，エ - ジングに特徴を有する もの	C	・・巻芯または素子周囲，例．巻止め テ - プ
	C	隔膜，隔離体，電解液または吸収体の 製造方法	D	・・端子の取付位置または電極箔の 位置関係
	D	電極の製造方法	E	・・複数の素子の組合せ
	E	固体電解コンデンサの製造方法	F	・積層型
	F	・固体電解質層の形成	G	電極箔一般
	G	・・TCNQ を用いたものの製造方法	H	チップ化
	H	・・導電性高分子を用いたものの製造 方法	Z	その他のもの
	J	容器への取付の製造方法	9/052	・・・焼結電極 [6]
	K	容器の製造方法	9/052 500	・・・粉末によるもの
	L	封止の製造方法	9/052 503	・・・非焼結電極
	M	膨張に対する弁その他の手段の製造 方法	9/052 505	・・・特に固体コンデンサに適合するもの
	N	電解コンデンサの電気材特性の修正 または補償用回路の製造方法	9/052 507	・・・特に液体コンデンサに適合するもの
	Z	その他のもの	9/052 509	・・・陽極箔
9/004		・細部 [6]	9/055	・・・エッチングした箔電極 [6]
9/008		・・端子 [6]	9/055 100	・・・陰極
9/008 301		・・・封口板に取付けられた接続端子	9/055 103	・・・固体コンデンサに適合する陰極， 例．カ - ボングラファイト層，銀 ペ - スト層または半田層
9/008 303		・・・リ - ドと電極箔との接続部に特徴を 有するもの	9/055 105	・・・液体コンデンサに適合する陰極
9/008 305		・・・陰極端子	9/055 107	・・・陰極ケ - ス
9/012		・・・特に固体コンデンサに適合するもの [6]	9/06	・・・容器への取付構造 [6]
9/012 301		・・・陰極端子またはリ - ドに特徴を有する もの	A	充填剤材料に特徴を有するもの
9/012 303		・・・陽極端子またはリ - ドに特徴を有する もの	Z	その他のもの
9/012 305		・・・チップ型素子に用いられるもの	9/07	・・誘電体層 [6]
9/012 307		・・・リ - ドフレ - ムまたはチェ - ンリ - ド構体	9/08	・・容器；外装 [6]
9/012 309		・・・その他のもの	A	被覆
9/02		・・隔膜；セパレ - タ [6]	B	・フィルム，シ - ト，チュ - プまたは スリ - プに関するもの
9/022		・・電解質；吸収体 [6]	C	・モ - ルド，ディップに関するもの
9/025		・・・固体電解質（H01G11/54 が優先）[6]	D	ケ - ス，例．二重容器
9/028		・・・有機半導体電解質，例．TCNQ[6]	E	・絶縁材料からなるケ - スに関する もの
	A	TCNQ に用いたもの	F	・金属ケ - スに関するもの
	B	・構造	Z	その他のもの
	C	・材料	9/10	・・・封止，例．リ - ド線の [6]
	E	導電性高分子に用いたもの	A	ハ - メチックシ - ル
	F	・構造	C	封口体と端子またはリ - ドとの封 止に特徴を有するもの
	G	・材料	D	封口体とケ - ス端部との封止に特 徴を有するもの
	Z	その他のもの	E	封口体材料に特徴を有するもの
			F	・多層構造
			G	チップ型素子に用いられるもの
			Z	その他のもの

9/12	・・・膨張に対する弁その他の手段 [6]	9/20 303	・・・封止
A	封口体に溝, 肉薄部分または防爆孔を有するもの	A	材料
B	容器に溝, 肉薄部分または防爆孔を有するもの	B	構造
C	保護装置, 例. ヒュ - ズ	C	製造方法
Z	その他のもの	Z	その他
9/14	・・・電解コンデンサの電気的特性の修正, または補償用構造的組合わせ	9/20 305	・・・電解液の注入
A	低インピーダンス化に特徴を有するもの	9/20 307	・・・光学部材, 例. 反射層, 散乱層または集光部材
B	無極化に特徴を有するもの	9/20 309	・・・視認性または意匠性
Z	その他のもの	9/20 311	・・・保護または短絡防止
9/145	・液体電解コンデンサ (H01G11/00 が優先) [6]	9/20 313	・・・評価または試験
9/15	・固体電解コンデンサ (H01G11/00 が優先) [6]	9/20 315	・・・他の電池または他の装置との組合せ
9/15 100	・・・巻回箔電極を用いるもの	9/20 317	・・・増感剤を用いないもの
9/16	・整流器または検波器として用いるため特に適合するもの (H01G9/22 が優先)	9/21	・感温装置 [6]
9/18	・自己遮断装置	9/22	・還元と酸化の組み合わせを用いる装置, 例 .Redox 装置, またはソリオン [1,2013.01]
9/20	・感光装置	9/26	・電解コンデンサ, 整流器, 検知器, 開閉装置, 感光装置または感温装置相互の構造的組み合わせ [6]
9/20 101	・・・セル	9/28	・電解コンデンサ, 整流器, 検知器, 開閉装置と, このサブクラスに包含されない他の電気構成部品との構造的組み合わせ [6]
9/20 103	・・・電解質	11/00	ハイブリッドコンデンサ, すなわち異なる正と負の電極をもつコンデンサ; 電気二重層 [EDL] コンデンサ; その製造のプロセスまたはその部品製造のプロセス [2013.01]
9/20 105	・・・固体, 例. ポリマ - またはゲル	ゲル - プ H01G11/02 は, ゲル - プ H01G11/04-H01G11/14 に優先する。[2013.01]	
9/20 107	・・・液体	11/02	・酸化還元反応を用いるもの, 例 .Redox 装置またはソリオン [2013.01]
A	溶質	11/04	・ハイブリッドコンデンサ [2013.01]
B	溶媒	11/06	・・・一方の電極の中にイオンが可逆的にド - プされているもの, 例 .リチウムイオンコンデンサ [LICs]」 [2013.01]
C	添加剤	11/08	・構造的な組合せ, 例. ハイブリッドまたは EDL コンデンサと他の電機部品の組み立てまたは連結, 少なくとも 1 つのハイブリッドまたは EDL コンデンサが主たる構成部品であること [2013.01]
Z	その他	11/10	・複数のハイブリッドまたは EDL コンデンサ, 例. アレイまたはモジュール (ハウジング, ケ - ス, カプセル化またはその取付け H01G11/78) [2013.01]
9/20 109	・・・セパレ - タまたはスペ - サ	11/12	・・・積層されたハイブリッドまたは EDL コンデンサ [2013.01]
9/20 111	・・・光電極	11/14	・ハイブリッドまたは EDL コンデンサを調整または保護するための装置または方法 (コンデンサに特に適合する緊急保護回路装置, および通常の動作条件から望まない変化を起こした場合に, 自動スイッチが実行される H02H7/16; 断絶せずに過電流または過電圧を制限するための非常保護回路装置 H02H9/00) [2013.01]
A	半導体層の材料	11/16	・・・電氣的過負荷に対するもの, 例. ヒュ - ズを含む [2013.01]
B	半導体層の構造	11/18	・・・熱的過負荷に対するもの, 例. 加熱, 冷却または通風 [2013.01]
C	半導体層の製造	11/20	・・・改善または不純物の除去の方法, 例. 洗浄 [2013.01]
D	導電層, 例. 透明導電層, または集電体	11/22	・電極 [2013.01]
E	基板	11/24	・・・電極を構成または組成する材料の構造的な特色に特徴を有するもの, 例. 形態, 表面積または空隙率; そこで用いられる粉末または粒子の構造的な特色に特徴を有するもの [2013.01]
Z	その他		
9/20 113	・・・増感剤		
A	有機色素		
B	金属錯体		
C	複数の増感剤の組合せまたは増感剤と他の吸着物質との組合せ		
D	吸着方法または吸着装置		
Z	その他		
9/20 115	・・・対極		
A	導電層, 例. 透明導電層または触媒層; 集電体		
B	基板		
Z	その他		
9/20 117	・・・セルの端子またはリ - ド		
9/20 119	・・・セル全体またはセル周囲の構造		
9/20 121	・・・セルの製造		
9/20 201	・・・モジュ - ル		
9/20 203	・・・モジュ - ルの構造		
A	セル間の導電接続		
B	・Z 型モジュ - ル		
C	・W 型モジュ - ル		
Z	その他		
9/20 205	・・・モジュ - ルの製造		
9/20 301	・・・タンデム型		

11/26	・・構造に特徴を有するもの, 例. 多層性, 空隙率または表面特性 [2013.01]	D	判別または検査
11/28	・・・集電体の上に並べられまたは配置されたもの; 電極と集電体の間の層または面, 例. 接着剤 [2013.01]	E	リ - ド端子の集合体; リ - ドフレ - ム
11/30	・・材料に特徴を有するもの [2013.01]	Z	その他のもの
11/32	・・・炭素をベ - スとするもの [2013.01]	13/00 303	・・リ - ドの加工
11/34	・・・炭化または賦活に特徴を有するもの [2013.01]	A	樹脂割れ抑制
11/36	・・・ナノ構造, 例. ナノファイバ -, ナノチューブまたはフラ - レン [2013.01]	B	リ - ド頭部加工
11/38	・・・カ - ボンペ - ストまたはブレンド; その中の結合剤または接着剤 [2013.01]	C	リ - ド表面処理
11/40	・・・繊維 [2013.01]	D	切断
11/42	・・・粉末または粒子, 例. それらの組成 [2013.01]	Z	その他のもの
11/44	・・・それらの原料, 例. 樹脂または石炭 [2013.01]	13/00 305	・・・フォ - ミング
11/46	・・・金属酸化物 [2013.01]	A	折曲げ; 切断および折曲げを伴うもの
11/48	・・・導電性ポリマ - [2013.01]	B	リ - ドの途中を彎曲
11/50	・・・リチウムイオンコンデンサに特に適合したものの, 例. リチウムのド - ビングまたはインタ - カレ - ションのためのもの [2013.01]	C	矯正
11/52	・セパレ - タ [2013.01]	Z	その他のもの
11/54	・電解質 [2013.01]	13/00 307	・・リ - ドの取付け
11/56	・・固体電解質, 例. ゲル; その中の添加物 [2013.01]	A	ステッチによるもの; 針で止めるもの
11/58	・・液体電解質 [2013.01]	B	リ - ド旗
11/60	・・・溶媒に特徴を有するもの [2013.01]	C	粉末成形プレスによるもの
11/62	・・・溶質に特徴を有するもの, 例. その中の塩, 陰イオンまたは陽イオン [2013.01]	D	ろう接
11/64	・・・添加剤に特徴を有するもの [2013.01]	E	半田, 例. 前半田または予備半田
11/66	・集電体 [2013.01]	F	溶接
11/68	・・材料に特徴を有するもの [2013.01]	Z	その他のもの
11/70	・・構造に特徴を有するもの [2013.01]	13/00 311	・テ - ビング (電気部品の組立体の製造または調整 H05K13/00; テ - ビング電気部品それ自体 B65D; テ - ビング電気部品の製造一般 B65B)
11/72	・・複数のまたは積層されたハイブリッドまたは EDL コンデンサの一体化に特に適合したもの [2013.01]	A	着テ - ビング
11/74	・端子, 例. 集電体の拡張 [2013.01]	B	離テ - ビング
11/76	・・複数のまたは積層されたハイブリッドまたは EDL コンデンサの一体化に特に適合したもの [2013.01]	Z	その他のもの
11/78	・ケ - ス; ハウジング; カプセル化; 取付け [2013.01]	13/00 321	・外装または容器
11/80	・・ガasket; シ - リング [2013.01]	A	塗装
11/82	・・コンデンサ要素のハウジング内への取付けまたは組立て, 例. 電極の取付け, 集電体または端子のコンテナ内への取付けまたはカプセル化 [2013.01]	B	テ - プ巻き
11/84	・ハイブリッドまたは EDL コンデンサ, またはそれらの部品の製造方法 [2013.01]	C	封口
11/86	・・電極に特に適合したもの (電極の製造のための炭化または賦活 H01G11/34) [2013.01]	D	包装
13/00	コンデンサの製造に適合した装置; グル - プ H01G4/00-H01G11/00 に分類されないコンデンサの製造に特に適合した方法 [2,2013.01]	E	樹脂外装
13/00 301	・リ - ド	F	被覆
A	挿入	G	チューブ装着
B	移送または供給	H	熱収縮チューブ
C	整列または位置決め	J	カラ - コ - ティング; マ - キング; 表示
		K	モ - ルド成型
		L	成型用金型
		Z	その他のもの
		13/00 331	・供給または位置決め
		A	供給
		B	挿入
		C	移送
		D	整列または位置決め
		E	取出し
		F	反転
		Z	その他のもの
		13/00 341	・組立
		13/00 351	・保持または治具
		A	治具
		B	吊持または挟持
		Z	その他のもの
		13/00 361	・試験または検査 (表示マ - ク H01G1/04)
		A	選別または自動選別

	B	極性判別	15/00	このサブクラスの異なるメイングル - プのうち, 少なくとも 2 つに包含されるコンデンサまたは他の装置の相互の構造的組合わせ (少なくとも 1 つのハイブリッドコンデンサまたは電気二重層 [EDL] コンデンサを主なコンポーネントとして含む H01G11/08) [6,2013.01]
	C	容量検出		
	D	漏洩電流検査, 例 . 特性劣化試験のためのもの		
	E	振動試験		
	F	充放電試験		
	G	耐圧試験	17/00	
	Z	その他のもの		複数個のコンデンサ, またはこのサブクラスの異なるメイングル - プのうち, 少なくとも 2 つに包含される他の装置との構造的組合わせであって, このサブクラスに包含されない他の電気素子を有するもの, 例 .RC 組み合わせ [6]
13/00	371	・電解コンデンサ用製造装置 (電解コンデンサの製造方法 H01G9/24)		
	A	整列または極性判別		
	B	吊持または保持		
	C	検査		
	D	エ - ジング		
	E	複数工程		
	F	化成, 例 . 誘電体被膜を形成するもの		
	G	電極箔, 例 . エッチングによる電極箔の形成		
	H	含浸		
	J	エッチング (H01G13/00,371J 優先)		
	Z	その他のもの		
13/00	381	・電気二重層コンデンサ用製造装置 (電気二重層コンデンサの製造方法 H01G11/84,11/86)		
13/00	391	・コンデンサの製造方法		
	A	エ - ジング ; 再化成		
	B	電極塗装		
	C	蒸着		
	D	メタリコン		
	E	焼成		
	F	キャップ製造		
	G	スリッティング, 例 . アルミ箔のスリッティング		
	H	切断, 例 . セラミックの切断		
	J	複数工程		
	Z	その他のもの		
13/02		・コンデンサ巻回機 [2]		
	A	容量調整		
	B	フィルムまたは箔の加工		
	C	巻芯		
	D	口 - ラ構造		
	E	供給		
	F	張力調整		
	G	ブレ - キ		
	H	切断		
	J	のり付け		
	K	複数工程のもの		
	L	測定または検査		
	M	巻取装置の構造		
	Z	その他のもの		
13/02	301	・・巻取方法		
	A	巻始め処理		
	B	巻終り処理		
	C	取り外し処理		
	D	同軸で多数巻取るもの		
	Z	その他のもの		
13/04		・乾燥 ; 含浸 [2]		
13/06		・金属表面を除去するための設備をもつもの [2]		